

期刊	封面特写	趋势与分析				设计与技术				
		产业前沿	高峰观点*	工程师社区*	EDN 评论	技术纵横	设计实例	设计解析	设计新视野	芯品汇
1月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2022年11月8日 材料提交截止日期: 2022年11月21日	嵌入式系统/开源硬件	•		•	•	FPGA	<ul style="list-style-type: none"> • 存储技术 • 触摸屏/HMI • 嵌入式模块/单板机 			新品推荐
2月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2022年12月8日 材料提交截止日期: 2022年12月20日	物联网/边缘智能	•	•	•	•	数据中心/云计算	<ul style="list-style-type: none"> • AR/VR • 存内计算 • 环境传感器 	•	存储器	新品推荐
3月刊 广告预订截止日期: 2023年1月6日 材料提交截止日期: 2023年1月16日	高效电源管理	•		•	•	无线充电	<ul style="list-style-type: none"> • 充电桩 • 电路保护 • BMS/wBMS 			新品推荐
4月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2023年2月8日 材料提交截止日期: 2023年2月20日	射频/无线通信	•	•	•	•	高速有线通信	<ul style="list-style-type: none"> • 接口 • 时钟 • 射频前端 	•	射频/模拟	新品推荐
5月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2023年3月8日 材料提交截止日期: 2023年3月20日	工业4.0/智能制造2025	•		•	•	工业物联网	<ul style="list-style-type: none"> • 3D打印 • 工业控制 • AR/VR 			新品推荐
6月刊 广告预订截止日期: 2023年4月7日 材料提交截止日期: 2023年4月20日	MCU/片上系统	•	•	•	•	机器人/无人机	<ul style="list-style-type: none"> • 电机控制/电机驱动 • 运动控制 • 智能家电 	•	MCU	新品推荐
7月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2023年5月8日 材料提交截止日期: 2023年5月19日	新能源/智能医疗	•		•	•	能量采集	<ul style="list-style-type: none"> • 生物识别 • 超级电容 • 智能电网 			新品推荐
8月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2023年6月8日 材料提交截止日期: 2023年6月20日	宽禁带半导体	•	•	•	•	新材料/新工艺	<ul style="list-style-type: none"> • 快速充电 • 散热管理 • 开关驱动 	•	功率器件	新品推荐
9月刊 广告预订截止日期: 2023年7月7日 材料提交截止日期: 2023年7月20日	智能家居/智慧城市	•		•	•	折叠屏/曲面屏	<ul style="list-style-type: none"> • 安防监控 • 微出行 • 高精度定位 			新品推荐
10月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2023年8月8日 材料提交截止日期: 2023年8月21日	人工智能/机器视觉	•	•	•	•	EDA/IC设计	<ul style="list-style-type: none"> • 图像传感 • 图像处理 • GPU/GPGPU 	•	处理器	新品推荐
11月刊 (数字版*) 广告预订截止日期: 2023年9月8日 材料提交截止日期: 2023年9月20日	测试测量	•		•	•	半导体封装/工艺	<ul style="list-style-type: none"> • 无线测试 • EMI/EMC • 虚拟测试/仿真 			新品推荐
12月刊 广告预订截止日期: 2023年10月9日 材料提交截止日期: 2023年10月20日	智能网联汽车	•	•	•	•	毫米波雷达/激光雷达	<ul style="list-style-type: none"> • ADAS • 信息娱乐 • 新座舱技术 	•	MEMS/传感器	模拟技术

* 仅限中国大陆版

编辑查询

有关中国大陆版的编辑及其他相关事项查询, 请与 Franklin Zhao (Franklin.Zhao@aspencore.com) 联系。

注: 发行人保留对以上文章删除及改动的权利。